

2012.2製造月以降

【Reference Data】FOMA UM02-KO
有害物質含有情報調査結果

本資料はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
詳細はJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。

ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度が最大の部品の質量および含有濃度(ppm)を記載し、横に個数を併記しております。

- ①コンデンサ、抵抗 → 大 小(縦×横)
②ダイオード、トランジスタ → 用途
③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約“情報の取り扱い”」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いいたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度(ppm)	含有質量(mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
レベルA (禁止物質)	A05	カドミウム又はその化合物	N	20	0.000010	PA1	はんだ合金中の不純物		
			N	20	0.0000082	PA2	はんだ合金中の不純物		
			N	20	0.0056	FOMAモジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
	A07	六価クロム化合物	N						
	A09	鉛及びその化合物	Y	1,500	0.0021	アイソレータ2のセラミック基板抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	500	0.0017	コネクタの雄端子	銅合金の成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	500	0.0050	コネクタのシェル	銅合金の成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	50,000	0.0084	多連チップ抵抗の裏電極	機械特性向上	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	50,000	0.011	多連チップ抵抗の表電極	機械特性向上	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	260,000	0.044	多連チップ抵抗の抵抗体	主成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	500,000	0.11	多連チップ抵抗の保護コート	主成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	750,000	1.1	水晶振動子のベース	封止	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	300	0.0043	FOMAモジュール基板の無電解ニッケルメッキ	添加剤	閾値以下 ネットワーク・インフラを構成する通信装置のホリ塩化ビニルケーブル及び無電解ニッケルメッキに含まれる鉛	
			N	1.6	0.00090	FOMAモジュール基板の銅メッキ	不純物		
			N	15	0.013	FOMAモジュール基板のプリプレグ	不純物		
			N	15	0.0029	FOMAモジュール基板のコア材	不純物		
			Y	1,000	3.3	シールドケース上	銅の合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	1,000	3.5	シールドケース下	銅の合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			N	500	0.00026	PA1	はんだ合金中の不純物		
			N	500	0.00021	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	50,000	0.0082	チップ抵抗(1005)(63個)の裏電極	機械特性向上	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	50,000	0.0088	チップ抵抗(1005)(63個)の表電極	機械特性向上	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	260,000	0.047	チップ抵抗(1005)(63個)の抵抗体	主成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			Y	500,000	0.11	チップ抵抗(1005)(63個)の保護コート	主成分	CRT、電子部品及び蛍光管のガラスの中の鉛	
			N	500	0.14	FOMAモジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		

2012.2製造月以降

【Reference Data】FOMA UM02-KO

有害物質含有情報調査結果

本資料はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
詳細はJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。

ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度が最大の部品の質量および含有濃度(ppm)を記載し、横に個数を併記しております。

- ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
②ダイオード、トランジスタ → 用途
③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約“情報の取り扱い”」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いいたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度(ppm)	含有質量(mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
	A10	水銀またはその化合物	N						
	A17	ビス(トリブチルスズ)＝オキシド(TBTO)	N						
	A18	トリブチルスズ類(TBT類)及びトリフェニルスズ類(TPT類)	N						
	B02	ポリ臭化ビフェニール類(PBB)	N						
	B03	ポリ臭化ジフェニールエーテル類(PBDE)	N						
	B05	ポリ塩化ビフェニル類(PCB)	N						
	B06	ポリ塩化ナフタレン(塩素係数が3以上)	N						
	B09	短鎖型塩化パラフィン	N						
	C01	アスベスト類	N						
	C02	アゾ染料・顔料	N						
	C04	オゾン層破壊物質	N						
	C06	放射性物質	N						
レベルB (管理)	A01	アンチモン及びその化合物	N	2,000	0.0012	SAWフィルタ1の外装樹脂	イオンキャッチャー		
			N	2,000	0.0012	SAWフィルタ2の外装樹脂	イオンキャッチャー		
			Y	10,000	0.012	FETの外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	18,000	0.20	汎用ロジックIC1のパッケージ	難燃剤		
			Y	2,700	0.45	ROMのエポキシ外装樹脂	難燃剤		メーカーは使用部位質量データを持っておらず、含有濃度は部品質量比。
			Y	14,000	0.025	GaAsデバイスのモールド樹脂	難燃剤		
			N	2,000	0.0041	LNAオーバコート樹脂	エポキシ系樹脂		
			Y	10,000	0.016	CMOS2のモールド樹脂	難燃助剤		
			Y	22,000	0.027	水晶振動子のリッド	素材		
			N	0.30	0.0000078	FOMAモジュール本体銘板基材	PET重合触媒		
			N	1,000	0.00052	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	2,000	0.011	PA1封止樹脂	改質材		
			N	1,000	0.00041	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	2,000	0.011	PA2封止樹脂	改質材		
			Y	35,000	0.0070	水没判定ラベル両面テープ基材	添加剤		
			Y	11,000	0.28	ダイオード(14個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	9,800	0.048	トランジスタ(4個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			N	1,000	0.28	FOMAモジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			N	250	0.00016	FOMAモジュールバーコード部	触媒残渣		
	A02	ひ素及びその化合物	N	21	0.00013	通信用IC1チップ	ドーパント		
			N	320	0.0020	専用IC2の基板	銅箔中の不純物		
			Y	100,000	0.094	LNA素子	GaAs素子		
			N	5.0	0.000044	通信用IC2チップ	ドーパント		
			N	60	0.000084	PA1の基板の銅箔	特性向上		
			N	54	0.000065	PA1の基板の銅箔	特性向上		
			N	300	0.00016	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	760,000	0.30	PA1の半導体チップ	成分		
			N	60	0.000068	PA2の基板の銅箔	特性向上		
			N	54	0.000052	PA2の基板の銅箔	特性向上		
			N	300	0.00012	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	760,000	0.30	PA2の半導体チップ	成分		
			N	300	0.084	FOMAモジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		

2012.2製造月以降

【Reference Data】FOMA UM02-KO 有害物質含有情報調査結果

本資料はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
詳細はJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。

ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度が最大の部品の質量および含有濃度(ppm)を記載し、横に個数を併記しております。
①コンデンサ、抵抗 →大 長さ(縦×横)
②ダイオード、トランジスタ → 用途
③コイル → 形状

・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約“情報の取り扱い”」に定められた文書となります。
・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いいたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度(ppm)	含有質量(mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
	A03	ベリリウム及び化合物	N						
	A04	ビスマス及びその化合物	N	2,000	0.0012	SAWフィルタ1の外装樹脂	構成材		
			N	2,000	0.0012	SAWフィルタ2の外装樹脂	構成材		
			Y	10,000	0.25	通信用IC1のモールド材	モールド添加材		
			Y	10,000	0.25	専用IC2のモールド材	モールド添加材		
			Y	52,000	0.074	水晶振動子のベース	封止		
			N	500	0.00026	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	4,000	0.021	PA1封止樹脂	改質材		
			N	500	0.00021	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	4,000	0.022	PA2封止樹脂	改質材		
			N	500	0.14	FOMAモジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
	A11	ニッケル(外部利用のみ)	N						
	A13	セレン又はその化合物	N						
	B07	ポリ塩化ビニル(PVC)	N						
	B08	臭素系難燃剤	Y	24,000	0.23	PA1の基板	難燃剤		
			N	2,000	0.00010	PA1のはんだ合金	難燃剤		
			Y	53,000	0.45	PA2の基板	難燃剤		
			N	2,000	0.00082	PA2のはんだ合金	難燃剤		
			N	86,000	0.052	アイソレータ1のスペーサ	難燃成分		
			Y	36,000	0.043	FETの外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	12,500	0.14	汎用ロジックIC1のパッケージ	難燃剤		
			Y	3,600	0.62	ROMのエポキシ外装樹脂	難燃剤		メーカーは使用部位質量データを持っておらず、含有濃度は部品質量比。
			Y	21,000	0.033	CMOS6のモールド樹脂	難燃剤		
			Y	14,000	0.025	GaAsデバイスのモールド樹脂	難燃剤		
			Y	37,000	0.12	ダイオード(14個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	35,000	0.13	トランジスタ(4個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
	C05	フタル酸エステル類	N						

注意事項

- ※ 含有濃度は購入先の報告値によります。
- ※ 本調査結果は、メーカーの購入先からの報告により記載しているものであり、含有・非含有または含有数量を保証するものではありません。